平成 20 年５月 21 日

各　　位

会 社 名　アピックヤマダ株式会社
代表者名　代表取締役社長　野中　正樹
（コード番号 6300 東証第二部）

# 新製品開発及び販売に関するお知らせ

当社は、次世代パッケージ技術として注目されているＥＷＬＰ（埋め込み型ウェハー・レベル・パッケージ）成形用として、業界初のオートモールド装置『ＷＬＰ－１００』を開発し、販売開始いたしましたのでお知らせいたします。

記

１．概要

ＷＬＰ技術は、半導体の小型化対応の手法として従来より理想のパッケージ技術として注目されてきましたが、多ピン対応への技術課題やプロセス開発が伴うことなどから主に小ピン製品に使用され、形態もウェハーそのものを樹脂成形するものでありました。近年になり、分離・検査済みチップをプレート上に配列し樹脂成形後に再配線層を形成するＥＷＬＰ方式が登場し、多ピン製品のみならずＳＩＰ（System In Package）への展開が可能となったことで半導体各社の取り組みが活発化しております。

当社では同方式の初期段階より顧客との共同開発に参加し、当社独自の液状樹脂圧縮成型技術ＣＤＩＭ（Cavity Direct Injection Mold）をベースに成形技術・搬送技術を構築し、商品化に成功いたしました。最大８インチのＥＷＬＰを２枚まで自動で供給・成形・収納できることに加え、顧客のプロセスニーズにあわせ検査機能などの機能付加に対応いたしました。また、将来の 12 インチ対応も視野に入れております。

なお、同機は既に受注確定分も含めまして５台以上の引合いを得ております。

２．販売価格

１台（１ウェハー取り）　約１億 5,000 万円

３．販売見込額

2008 年度　３億円
2009 年度　10 億円

以　上

＜お問い合わせ先＞
担当：営業部　部長代理　押森広仁
ＴＥＬ：026－276－8111